

**Mate 2002 第8回シンポジウム「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」**  
《ブロードバンドインターネット時代に向けた生産の科学と技術革新》参加者募集

**主催：**(社)溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
**共催：**(社)機械学会 エレクトロニクス実装における信頼性設計に関する研究分科会、  
(社)高温学会 加工・再生研究情報委員会、  
(社)日本塑性加工学会 接合・複合分科会、  
レーザ加工学会、  
技術研究組合 超先端電子技術開発機構 (ASET)  
電子SI技術研究部、  
IMS プロジェクト 環境対応次世代接合技術の開発、  
大阪大学 先端科学技術共同研究センター

**開催趣旨**

21世紀はIT革命の時代とも言われ、エレクトロニクス類は高速大容量通信対応に変革していきます。20世紀後半におけるエレクトロニクスデバイス・製品の多様化、高密度化、高機能化の進展はめざましいものがあり、マイクロ接合、パッケージング・アセンブリ技術を中心とした生産技術の顕著な革新がありました。今世紀においてもこれら生産技術に対する要求や対象となる材料はますます広がりを見せてきており、ブロードバンドインターネット時代における生産技術の果たす役割は今まで以上に重要となってきています。今後とも先鋭化・多様化する要求に応えていくには、本シンポジウムの対象としているマイクロ接合、パッケージング・アセンブリ技術を中心に、高速大容量対応製品製造のための生産技術の体系化と科学的探求が強く要望されています。本シンポジウムでは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。

**日時：**平成14年1月31日(木) 8:50～17:55

平成14年2月1日(金) 9:00～18:00

**会場：**パシフィコ横浜 会議センター

5階(小ホール, 501,502)

横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

TEL: 045-221-2121

**シンポジウム参加登録費(論文集代を含む)**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| ○主催・共催団体登録会社    | : 20,000円 |
| ○溶接学会、協賛学協会会員会社 | : 30,000円 |
| ○論文口頭発表者        | : 15,000円 |
| ○大学・国公立研究機関     | : 10,000円 |
| ○学生             | : 5,000円  |
| ○その他(一般)        | : 40,000円 |

**シンポジウム参加申し込み方法**

所定の用紙に必要事項(申込者氏名、連絡先住所、電話番号、FAX番号など)を記入し、次の申込先にお申し込み下さい。受付次第、参加受付書を返送させていただきます。参加登録料は、現金書留、郵便振替、銀行振込のいずれかでお支払い下さい。

問合せ、申込先：(社)溶接学会 Mate 2002事務局

担当連絡先：TEL: 06-6879-8698, FAX: 06-6878-3110

E-Mail: mate@jwri.osaka-u.ac.jp

**参加申し込み締め切り日：**平成14年1月21日(月)

**振込先銀行：**三井住友銀行 豊中支店

口座番号：普通 No.1962097

口座名義：Mate組織委員会 仲田 周次

**シンポジウムURL**

<http://wwwsoc.nii.ac.jp/jws/research/micro/mate/Mate2002.html>

**プログラム(セッション名と発表件数)**

1月31日(木) 8:50～17:55 (18:00～懇親会)

◆プレナリーセッション

「ブロードバンドインターネット時代に向けた生産の科学と技術革新」

[A-1]開発 (5件)

[A-2], [A-3]ワークショップ

「2001年度上期ASET電子SI技術研究中間報告と将来の課題ー超高速ブロードバンド対応電子SI技術研究ー」

[B-1]ソルダリング (5件)

[B-2]ソルダ材料 (5件)

|                     |      |
|---------------------|------|
| [B-3]鉛フリーソルダリングⅠ    | (6件) |
| [C-1]膜・界面           | (5件) |
| [C-2]企画セッション：環境共生   | (5件) |
| [C-3]企画セッション：機械的信頼性 | (5件) |

2月1日（金） 9:00～18:00

|                  |      |
|------------------|------|
| [A-4]基板・回路形成     | (5件) |
| [A-5]パンプ実装Ⅰ      | (5件) |
| [A-6]パンプ実装Ⅱ      | (6件) |
| [A-7]接着実装        | (5件) |
| [B-4]鉛フリーソルダリングⅡ | (5件) |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| [B-5]鉛フリーソルダリングⅢ      | (5件) |
| [B-6]ソルダリング部の信頼性Ⅰ     | (6件) |
| [B-7]ソルダリング部の信頼性Ⅱ     | (5件) |
| [C-4]企画セッション:塑性加工・接合Ⅰ | (2件) |

[講演]「変形加工技術を用いた高付加価値接合・複合－  
その考え方と幾つかの事例－」

|                       |      |
|-----------------------|------|
| [C-5]企画セッション:塑性加工・接合Ⅱ | (4件) |
| [C-6]企画セッション:レーザ加工    | (5件) |
| [C-7]評価・検査            | (5件) |

(一般論文発表合計94件)